中信证券股份有限公司关于普冉半导体(上海)股份有限公司2022年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称“普冉股份”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，负责普冉股份上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案。本持续督导期间，未发生协议内容做出修改或终止协议的情况。
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	本持续督导期间，上市公司未发生需公开发表声明的违法违规事项。
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	本持续督导期间，上市公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项。
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	本持续督导期间，保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查、尽职调查等方式，对上市公司开展持续督导工作。其中，保荐机构于2023年4月10日对上市公司进行了现场检查。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	保荐机构持续督促、指导上市公司及其董事、监事、高级管理人员，本持续督导期间，上市公司及其董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求，并切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促普冉股份依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对普冉股份的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，普冉股份的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促普冉股份严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对普冉股份的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对上市公司的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
12	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管措施或纪律处分的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	本持续督导期间，上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况。
13	关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，保荐人应及时向上海证券交易所报告。上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的，保荐机构、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。保荐机构、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、上市规则以及上海证券交易所其他规定的，保荐机构和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。	本持续督导期间，上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。上市公司或其控股股东、实际控制人已对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。
14	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时对对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，上市公司未出现该等事项。
15	在持续督导期间发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：(一)上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；(二)中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；(三)上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；(四)上市公司不配合保荐机构持续督导工作；(五)上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

(一)业绩大幅下滑或亏损的风险

受全球宏观经济下行、国际形势紧张等因素影响，下游消费类需求萎靡，半导体设计行业进入下行周期，导致公司产品单价及营业收入下降，在下游库存高企，企业存货周转率降低的情况下，公司高价格库存产品周转变慢，导致产品毛利下降，而同时公司又处于研发高投入发展阶段，因此业绩出现大幅下滑。目前全球宏观经济尚未回暖，公司在费用支出上已进行谨慎控制，但仍然需要继续投入研发，且人力成本上涨存在刚性特征，如营收未能恢复增长，则业绩存在继续下滑或亏损的风险。

(二)核心竞争力风险

1、产品研发风险

近年来，集成电路行业按照摩尔定律继续发展演变，芯片的集成度和性能不断改善升级，以及芯片设计公司需要不断推出适应市场的新产品、新技术以顺应市场需求的变化。

存储器芯片产品的标准化程度较高，差异化竞争较小，因此技术升级是存储器芯片公司间竞争的主要策略，存储器芯片的技术升级主要体现在工艺制程和产品性能两方面。

NOR Flash工艺制程从90nm发展到了65nm、55nm和40nm；EEPROM的工艺制程和存储单元逐步实现了从0.35um/7.245um2、0.18um/2.88um2、0.13um/1.64um2、0.13um/1.26um2、0.13um/1.01um2向95nm及以下制程的升级，以降低产品单位成本和提高产品竞争优势。

除了工艺制程升级外，随着存储器芯片的应用场景越来越多样化，下游客户对芯片性能的要求也日趋多样，尤其是可穿戴设备、物联网设备的兴起提高了客户对芯片的功耗、面积等性能的要求。

因此，如未来下游客户继续对存储器芯片性能提出新的需求，而公司在现有的低功耗NOR Flash和高可靠性EEPROM的产品体系基础上未能进一步实现产品的性能升级，或公司在产品的工艺制程升级上落后于同行业竞争对手导致单位成本不具备优势，将对公司的经营业绩增长造成不利影响。

与此同时，公司布局微控制器芯片及音圈马达驱动芯片领域，由于芯片设计对技术要求高、相关工艺技术复杂，流片成本较高，若公司新产品研发失败，存在前期研发投入无法收回的风险，将会对公司的经营带来不利的影响。

2、基础工艺技术授权到期风险

公司已付费购买赛普拉斯的40nm和55nm SONOS工艺的授权，授权截止时间为2028年12月31日，用于公司NOR Flash产品的研发设计。赛普拉斯因被英飞凌收购，自2020年1月1日起，其与公司就SONOS工艺的授权协议所约定的权利义务均转移至英飞凌继续履行。

获得第三方公司知识产权许可或引入相关技术授权是集成电路的行业惯例。同时，赛普拉斯授权使用的SONOS工艺技术属于集成电路领域广泛使用的基础性技术平台，但如在授权有效期截止前赛普拉斯终止该授权合作或到期后赛普拉斯不再与公司就该授权合作进行续期，公司将无法进行SONOS工艺下的NOR Flash研发设计及生产，将对公司的正常经营造成不利影响。

3、主营业务市场规模相对较小，公司竞争实力有待提高的风险

存储器芯片市场由DRAM、NAND Flash和NOR Flash、EEPROM等细分市场组成，据SEMI最新数据，2021年全球DRAM全球市场规模约869亿美元，NAND Flash全球市场规模约636亿美元，NOR Flash和EEPROM市场规模约39.5亿美元，其中DRAM和NAND Flash占据了存储器芯片市场的主要份额。2022年公司营业收入主要来源于NOR Flash和EEPROM两大类非易失性存储器芯片，占主营业务收入的比例合计94.27%，主要经营的NOR Flash和EEPROM产品所在的市场规模相对较小。此外，NOR Flash和EEPROM市场已经经历了数十年的发展，成立时间较早的华邦、旺宏、兆易创新等NOR Flash厂商以及意法半导体等EEPROM厂商已经在收入规模、业务毛利率、专利技术等方面具备了一定的先发优势，并保持着较高的研发投入水平和研发人员数量，公司作为市场新进入者，面临一定的外部竞争压力，综合实力有待提升。

综上所述，虽然公司现阶段的业务规模较小、公司的市场占有率仍有增长空间，但是长期来看，如果公司不能及时扩展产品体系或未能较好地应对外部竞争压力、全球NOR Flash和EEPROM市场规模增长停滞，可能面临因市场规模相对较小或外部竞争处于下风而导致经营业绩长期增长承压的风险。

4、公司各产品线业务存在市场竞争加剧的风险

NOR Flash市场中，由于NOR Flash市场规模相对较小且竞争日趋激烈以及DRAM、NAND Flash需求爆发，国际存储器龙头纷纷退出中低端NOR Flash市场，产能或让位于高毛利的高容量NOR Flash，或转向DRAM和NAND Flash业务。美光和赛普拉斯分别在2016年和2017年开始减少中低端NOR Flash存储器产品产能。

全球NOR Flash主要市场份额由华邦、旺宏、兆易创新、赛普拉斯和美光等国内外大型厂商占据，而全球EEPROM主要市场份额由意法半导体、安森美、聚辰股份等厂商占据。公司在整体规模、资金实力、海外渠道等方面仍然存在一定差距。如果公司不能够保证产品良好的竞争力以应对市场竞争压力，可能面临因市场竞争导致产品价格和利润空间缩减以及经营业绩不及预期的风险。

MCU市场中，根据IC Insights预测，2022年全球MCU销售额相较于2021年将增长10%，达到215亿美元的历史新高，其中汽车MCU的增长将超过大多数其他终端市场，全球市场份额主要由意法半导体、瑞萨、恩智浦为代表的海外大型厂商占据。公司目前产品主要应用领域为消费类，且作为市场新进入者，可能面临因市场竞争导致产品导入、产品价格和利润等不及预期的风险。

5、产品质量风险

芯片产品的质量是公司保持竞争力的基础。由于芯片产业的高度复杂性，公司无法完全排除因不可控因素导致出现产品质量问题。若公司产品质量出现缺陷或未能满足客户对质量的要求，公司可能需承担相应的退货和赔偿责任并可能对公司经营业绩、财务状况造成不利影响；同时，公司的产品质量问题亦可能对公司的品牌形象、客户关系等造成负面影响，不利于公司业务经营与发展。

6、人才流失风险

芯片设计行业属于技术密集型产业，对技术人员的水平要求较高，行业内优秀的人才较为短缺。同行业竞争对手仍可能通过更优厚的待遇吸引公司技术人才，或公司受其他因素影响导致公司技术人才流失，将对公司新产品的研发以及技术能力的储备造成影响，进而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

7、知识产权风险

芯片设计属于技术密集型行业，该行业知识产权众多。在产品开发过程中，涉及到较多专利及集成电路布图等知识产权的授权与许可。未来不能排除竞争对手或第三方采取恶意诉讼的策略，阻滞公司市场拓展的可能性。同时，也不能排除竞争对手窃取公司知识产权非法获利的可能性。

(三)经营风险

1、供应商集中度较高与其产能利用率周期性波动的风险

晶圆制造、晶圆测试和封装测试均为资本及技术密集型产业，相关行业集中度较高。报告期内，公司的晶圆代工主要委托华力和中芯国际进行，公司的晶圆测试和封装测试主要委托紫光宏茂、上海伟测和盛合晶微、华天科技、通富微电等厂商进行，公司供应商集中度较高。

2022年因下游需求萎靡等原因，产能释放程度较大，产能利用率有所降低，但如果上述供应商发生不可抗力的突发事件，或因集成电路市场需求旺盛出现产能紧张等因素，晶圆代工、晶圆测试和封装测试产能可能无法满足需求，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

(四)财务风险

1、毛利率波动的风险

根据集成电路行业特点，产品毛利率受到市场需求、产能供给等多方面因素影响，公司需根据市场需求不断进行产品的迭代升级和创新，以维持公司较强的盈利能力。若公司未来营业收入规模出现显著波动，或受市场竞争影响导致产品单价进一步下降，或受产能供应影响导致产品单位成本上升，公司将面临毛利率波动或下降的风险。

2、应收账款的风险

随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额可能逐步增加。如果后续公司不能对应收账款进行有效控制，无法按时收回到期应收账款，或因宏观经济形势下行、市场情况恶化等因素出现重大应收账款不能收回的情况，将增加公司资金压力，导致公司计提的坏账准备大幅增加，从而对公司未来经营业绩造成重大不利影响。

3、存货跌价风险

公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品和发出商品构成。截至2022年期末，公司存货账面价值为67,026.85万元。公司每年根据存货的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备，2022年，公司存货跌价准备余额为7,074.48万元，占同期存货账面余额的比例分别为9.55%。若未来市场环境发生变化、市场需求下降、竞争加剧或技术更新导致存货过时，使得产品滞销、存货积压，将导致公司存货跌价风险增加，对公司的盈利能力产生不利影响。

4、募投项目实施后折旧及摊销费用大幅增加的风险

募投项目建成后，将新增大量固定资产、无形资产、研发投入，年新增折旧及摊销费用较大。如果行业或市场环境发生重大不利变化，募投项目无法实现预期收益，则募投项目折旧及摊销费用支出的增加可能导致公司利润出现一定程度的下滑。

(五)行业风险

公司所在的半导体设计行业进入下行周期，行业增速放缓，随着产能结构性缓解，行业存货周转速度变慢，以消费电子产品为代表的部分芯片需求呈现下滑趋势。公司产品在消费电子领域占比较大，虽然公司产品均为通用产品，且在工业控制及通讯、车载电子等领域持续推进，提高公司抗波动能力，但如果出现行业性的增长放缓，可能对公司业绩造成不利影响。

同时，公司所在的半导体芯片行业受国家政策鼓励影响发展迅速，一方面，行业内企业数量增加迅速，一方面行业内企业不断结合自身优势拓展市场。国内非易失性存储器芯片及微控制器芯片的市场参与者数量不断增多，市场也进一步分化，公司面临的市场竞争逐渐加剧，若未来公司无法正确把握市场动态及行业发展态势，无法根据客户需求开发相应产品，无法结合市场需求进行相应产品创新、开发，则公司的行业地位、市场规模、经营业绩将受到一定影响。

(六)宏观环境风险

2020年以来全球贸易规模下行压力较大，加之全球主要经济体贸易摩擦持续升温，地缘政治风险逐渐增大，甚至极端恶化并发生战争，全球贸易环境恶化，全球经济发展存在极大不确定性，加之美国商务部工业与安全局(BIS)公布的多项对于中国出口管制规定，对我国集成电路行业造成一定的冲击。宏观经济下行的风险或将对公司所处行业造成冲击，短期内造成下游客户需求疲软，或有可能影响公司相关业务的开展。

四、重大违规事项

2022年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2022年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	924,828,277.26	1,102,924,005.84	-16.15
归属于上市公司股东的净利润	83,146,348.73	291,150,636.69	-71.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,072,585.90	273,110,636.40	-87.89
经营活动产生的现金流量净额	-130,443,907.74	181,786,418.71	-171.76
主要会计数据	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,984,124,634.38	1,931,920,162.40	2.70
总资产	2,406,544,942.85	2,024,718,068.86	18.86
主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.64	6.89	-76.20
稀释每股收益(元/股)	1.63	6.88	-76.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.65	6.46	-89.94
加权平均净资产收益率(%)	4.24	30.58	减少26.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.69	28.69	减少27.00个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	16.07	8.3	增加7.77个百分点

报告期内归属于上市公司股东的净利润同比减少20,800.43万元，降幅71.44%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少24,003.81万元，降幅87.89%。公司本期净利润减少主要有以下原因：

1、营业收入减少：2022年度营业收入同比减少17,809.57万元，降幅16.15%，主要系报告期内，在国际形势紧张、全球经济及半导体周期下行等宏观因素影响下，半导体设计行业进入下行周期，景气度较2021年有大幅度的下降，同时，全球经济总量增速放缓，消费动力不足，对公司的主营业务收入规模造成了冲击，原有存储产品线出货量下降，新产品推出后的上量未达预期；

2、毛利率的下降：报告期内，公司基于经济形势和市场供需情况，积极巩固市场份额，对于原有的存储芯片产品线采取了适当降价去库存的定价策略。同时，由于代工价格变动相对存在一定的滞后，公司在报告期销售的主要产品的原材料采购价格仍相对较高，芯片产品的价格与毛利均承受了较大的压力。报告期内公司产品综合毛利率为29.85%，较去年同期下降6.38个百分点。

3、期间费用的增长：公司持续重视产品研发和下游应用结构的优化，保持高强度的研发投入。报告期内研发费用较上年增加5,710.49万元，增幅比例达62.42%。公司的规模扩大使得销售、管理人员也有所增加，报告期内销售费用和管理费用增幅分别为27.95%和32.34%。此外，股权激励的实施使得股份支付成本较上年增长696.64万元；

4、存货跌价准备的计提：2022年期末，本公司以存储类产品为代表的部分下游产品需求减少、价格下降，识别到的可变现净值低于账面成本的存货数量增加，因此2022年度新增计提存货跌价准备6,793.27万元。同时，由于报告期内部分前期已计提减值的产品出售，2022年度在原已计提的存货跌价准备金额内，转回存货跌价准备564.00万元。

5、公司于2021年5月29日被认定为国家重点集成电路设计企业，2021年享受免征企业所得税的税收优惠政策，2022年起，公司按10%的优惠税率征收企业所得税，所得税费用较2021年增长609.36万元。

报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少31,223.03万元，降幅171.76%。主要系：

1、公司下游客户因受行业周期影响，账期有所延长，回款速度放缓；

2、为保证公司业务正常开展，公司主动增加备货，向上游支付较多货款；

3、公司员工人数显著增长，工资薪金支付增加。

六、核心竞争力的变化情况

(一)公司的核心竞争力

1、核心技术优势

公司自创立以来，专注于存储器芯片的技术研发和产品创新。以技术创新为基础，通过持续的创新研发和技术积累，现已形成具备完整的核心技术和产品体系。同时，公司推出“存储+”规划和长期战略，积极拓展通用微控制器和存储结合模拟的全新产品线。

NOR Flash方面，公司创新性地将电荷俘获技术的SONOS工艺应用在NOR Flash的研发设计中，并与晶圆厂联合开发和优化55nm及40nm NOR Flash工艺制程的NOR Flash芯片，使得公司的NOR Flash芯片具备了宽电压、超低功耗、快速擦除和高性价比等特点以及领先的成本优势。同时，公司也基于ETOX工艺延伸产品进行布局，目前工艺制程为50nm节点，以中大容量市场为主，衔接SONOS工艺下的中小容量市场。随着公司和下游客户之间业务的不断开展，公司NOR Flash产品的功耗、稳定性和兼容性得到了国内外客户的认可，出货量逐年增长，公司已经逐渐成为了NOR Flash市场中重要的供应商之一。

MCU方面，公司在芯片中嵌入Flash和SRAM存储器，结合基本逻辑工艺的低功耗特征和低功耗技术，使得公司的MCU芯片产品具备与公司SONOS NOR Flash一脉相承的低功耗、高可靠性、高性价比和优越的抗电磁干扰性能等特点。

EEPROM方面，公司联合晶圆厂优化130nm及95nm及以下工艺制程下的制造工艺，针对存储单元的结构、擦写电压进行了改造和优化，有效的缩小了芯片面积，在保障可靠性的前提下有效的降低了芯片的单位成本。公司积极响应市场需求、发挥技术优势，实现了地址编程、区域保护等特色功能，满足了客户对摄像头模组中的参数的保护诉求，极大地提升了公司产品的市场竞争力并保障了公司的盈利能力。综合来看，公司EEPROM产品的可靠性、功耗等性能指标均表现优异。

公司的核心技术均属于自主知识产权，并形成了有规划、有策略的专利布局。截至2022年12月31日，公司已获授权的发明专利达31项，集成电路布图设计证书33项，已经建立起了完整的自主知识产权体系。

2、核心团队优势

公司自创立以来，专注于持续的技术研发和产品创新，持续的研发创新帮助公司在产品性能上取得重要的技术突破，形成了“存储”及“存储+”两大产品模块。公司创始团队和技术团队曾经在NEC、华虹NEC、中芯国际、Integrated Device Technology,Inc.(IDT)、旺宏、Silicon Storage Technology,Inc.、SONY等国内外知名公司有多年研发和管理经历，核心技术人员平均工作超过十五年，具备深厚的IDM、Foundry和Fabless行业经验，具备综合竞争优势；

(1)公司拥有丰富的与晶圆代工厂合作开发先进工艺制程的产业经验，具备推动存储器技术升级和存储单元及相关器件的优化的研发能力；

(2)公司作为Fabless设计公司，拥有持续成功的产品开发量产经验，形成存储器和数模混合芯片领域的设计优势，产品具备领先的低功耗、宽电压等优势；

(3)公司基于IDM的工艺和产品协同开发经验，通过优化产品的设计架构与工艺，能够最大程度地实现对产品性能、可靠性和芯片面积的优化；

(4)公司基于与晶圆厂的长期合作和战略协同，提高了工艺开发和产品迭代的效率，使公司的产品具备业界领先的工艺节点和存储单元性能及尺寸。

公司核心团队在技术研发、市场销售、工程管理等领域均有着丰富的阅历和实战经验。公司自成立以来就十分注重人才的培养和创新，目前已培养了众多存储器芯片设计领域的专业技术人才，同时，公司重视针对新研发业务的优质行业人才引进，凭借独特的企业文化、优于同行的员工激励机制及已构建的品牌优势，不断吸收优秀的研发人才，为公司的产品升级和业务拓展奠定良好的研发团队基础。

3、客户资源拓展迅速

经过多年的发展和积淀，凭借低功耗、高可靠性等产品优势，公司已成为国内重要存储器芯片供应商之一，得到了客户的广泛认可。

目前公司核心产品广泛应用于各类TWS蓝牙耳机、工业控制、汽车电子、可穿戴设备、手机摄像头模组、AMOLED、家电、TDDI等领域，公司在国内市场覆盖了OPPO、vivo、荣耀、小米、联想、美的等众多知名企业，同时不断拓展海外市场，覆盖三星、松下、惠普、希捷等知名终端客户，并与Dialog Semiconductor(DLG)等主控原厂建立了稳定的合作关系。凭借国内外客户资源的迅速拓展，近年来公司经营业绩保持高速增长。

4、产品体系优势

公司已推出的产品体系覆盖了EEPROM和NOR Flash，均具备优异的产品性能和较强的市场竞争力。首先，公司的存储器芯片产品容量覆盖2Kbit-128Mbit、支持宽电压操作，可满足不同场景下的数据存储需求和完整解决方案，例如手机摄像模组中的2D和3D应用场景；其次，公司提供超小型封装方案，包括1.5mm*1.5mm USON封装和最小0.575mm*0.575mm的WLCSP封装，并在通讯产品中采用领先的Fan-out技术，满足下游客户对存储器芯片的小型化需求；最后，公司提供合封和外挂的两种选择方案，适用不同的客户场景需求。

因此，公司是行业内为数不多的同时具备EEPROM和NOR Flash产品线的芯片设计公司，能够针对客户不同的容量、功能和封装需求，提供综合性存储器芯片解决方案。

(二)核心竞争力变化情况

2022年，公司的核心竞争力未发生重大变化，但是受全球宏观经济下行、国际形势紧张等因素影响，下游消费类需求萎靡，半导体设计行业进入下行周期，导致公司产品单价及营业收入、毛利率均出现不同程度下降，公司2022年业绩大幅下滑，如未来营收未能恢复增长，则业绩存在继续下滑或亏损的风险。

七、研发支出变化及研发进展

2022年，公司坚持做好主营业务，持续保持有质量发展，在已销的产品稳步增长的前提下，加强研发投入，业务保持稳定增长。2022年公司研发费用为14,859.36万元，研发投入金额较上年同期增长62.42%。

报告期内，公司在存储器芯片领域持续拓展，进行40nm以下新一代工艺和浮栅下一代技术创新技术储备，并在存储领域延展ETOX工艺技术开发中大容量NOR Flash产品，同时布局“存储+”战略，包括基于ARM内核的32位MCU芯片多颗产品实现研发并部分产品量产出货，以及应用于摄像头模组的高性能VCM Driver芯片系列模拟产品。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致(如有)

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

1、截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

银行名称	账号	账户性质	期末余额
招商银行上海分行营业部	121937105210406	活期存款	32,115,164.69
招商银行上海分行营业部	121937105210909	活期存款	9,607,716.49
招商银行上海分行营业部	121937105210102	活期存款	95,172,775.26
上海银行金桥支行	03005006367	活期存款	557,723.44
上海银行股份有限公司金桥支行	3004654788	活期存款	12,389.73
中信银行股份有限公司上海虹桥支行	8110201013101356343	活期存款	18,346.38
合计			137,484,115.99

2、截至2022年12月31日，募集资金用于现金管理的情况如下：

单位：元

银行名称	账号	账户性质	期末余额
上海银行股份有限公司金桥支行	23002612119	七天通知存款	11,594,281.01
上海银行股份有限公司金桥支行	23002609703	七天通知存款	249,516,880.98
上海银行股份有限公司金桥支行	23002453867	七天通知存款	23,253,795.64
中信银行股份有限公司上海虹桥支行	8110201033001537112	七天通知存款	299,567,486.73
浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行	3101001020100046726	协议存款	313,460,809.80
合计			897,393,254.16

公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，普冉股份对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至2022年12月31日，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	任职情况	持股情况
1	王楠	董事长、总经理、核心技术人员	直接持股9,499,377股，并持有上海志颀18.72%的出资份额、宁波志冉33.20%的出资份额和宁波志旭22.14%的出资份额。
2	孙长江	董事、副总经理	直接持有上海志颀16.50%的出资份额
3	李兆桂	董事、副总经理、核心技术人员	直接持股2,463,731股，并持有上海志颀6.93%的出资份额。
4	陈凯	董事	直接持股63,403股。
5	陈涛	监事会主席、职工监事、核心技术人员	直接持有上海志颀9.79%的出资份额
6	冯国友	监事、核心技术人员	直接持有上海志颀4.84%的出资份额
7	童红亮	副总经理	直接持有上海志颀10.65%的出资份额
8	徐小祥	副总经理	直接持有上海志颀5.26%的出资份额
9	曹余新	副总经理	直接持有上海志颀4.84%的出资份额
10	钱佳美	董事会秘书、财务负责人	直接持有宁波志旭7.14%的出资份额
11	汪齐方	高级专家工程师兼资深经理、核心技术人员	直接持有宁波志冉9.52%的出资份额

注1：截至2022年12月31日，上海志颀直接持有公司股份9,311,516股。

注2：截至2022年12月31日，宁波志冉持有上海志颀6.31%的出资份额，宁波志旭持有上海志颀4.21%的出资份额。

截至2022年12月31日，董事陈凯因公司实施资本公积转增股本，增加股份24,115股，其持有的全部股份于2022年8月23日解禁流通，此后，因个人资金需要进行减持，共减持公司股份21,000股；此外，公司董事、监事、高级管理人员持有的中信证券－中信银行－中信证券普冉股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，通过公司2021年资本公积转增股本后，持有850,415股，其持有的全部股份于2022年8月23日解禁流通，并在2022年全部减持。

除上述情况外，公司董事、监事及高级管理人员不存在质押、冻结及减持情况。

十一、保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

保荐代表人：王建文 赵 亮

中信证券股份有限公司

2023年4月14日

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-012

陕西莱特光电材料股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人减持达到1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次权益变动为履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。

●本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会使陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人发生变化 。

●本次权益变动后，北京君联成业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“君联成业”)持有公司股份由21,234,294股变更为18,303,950股，持股比例由5.28%变更为4.55%、北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“君联慧诚”)持有公司股份由16,922,464股变更为14,568,700股，持股比例由4.20%变更为3.62%。

君联成业及其一致行动人君联慧诚合计持有公司股份由38,156,758股变更为32,872,650股，持股比例由9.48%变更为8.17%。

公司于2023年4月14日收到公司股东君联成业、君联慧诚发来的《关于对持有陕西莱特光电材料股份有限公司减持股份累计达到1%的告知函》。

一、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	北京君联成业股权投资合伙企业(有限合伙)
	注册地址	北京市海淀区科学院南路2号院1号楼16层1602室
	名称	北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙)
	注册地址	北京市海淀区科学院南路2号院1号楼16层1603室
	权益变动时间	2023年4月10日-2023年4月14日

权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股份(股)	减持比例
	集中竞价	2023年4月14日	人民币普通股	284,108	0.07%
	大宗交易	2023年4月10日-2023年4月14日	人民币普通股	5,000,000	1.24%
	合计			5,284,108	1.31%

备注：

1、本次权益变动主体存在一致行动人关系，君联成业的普通合伙人北京君联同道投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人君联资本(深圳)管理有限公司与君联慧诚的普通合伙人拉萨君祺企业管理有限公司均系君联资本管理股份有限公司持股100%的企业；君联慧诚持有君联成业70.09%的合伙份额，两者具有一致行动关系。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

3、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

4、表格中数据尾差为四舍五入所致。

二、本次权益变动前后信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
君联成业	无限售条件流通股	21,234,294	5.28%	18,303,950	4.55%
君联慧诚	无限售条件流通股	16,922,464	4.20%	14,568,700	3.62%
合计		38,156,758	9.48%	32,872,650	8.17%

备注：

1、本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

2、表格中数据尾差为四舍五入所致。

三、其他情况说明

1、本次权益变动为减持，不触及要约收购、不涉及资金来源；

2、本次权益变动为履行减持股份计划，具体内容详见公司2023年3月22日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号：2023-003)。截至本公告披露日，本次减持股份计划尚未实施完毕。

3、本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会使公司控股股东、实际控制人发生变化；

4、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

5、公司将继续严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2023-012
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码